

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

### 晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

### 正面盈利預告

本公告乃由晶門半導體有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱作「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.09(2)(a)條及香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XIVA 部的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據本集團截至 2021 年 6 月 30 日止六個月之未經審核綜合管理賬目初步審閱及董事會目前可得資料，本集團截至 2021 年 6 月 30 日止六個月預期錄得未經審核股東應佔綜合溢利約 1,000 萬美元，而 2020 年同期則錄得未經審核股東應佔綜合溢利約 440 萬美元。

本集團表現改善主要原因來自(i) 本集團的 IC 產品銷量增長約 20%；(ii) 本集團收入金額增加超過 20%；(iii) 因材料價格和生產成本大幅上漲而提高平均售價；及(iv) 因銷售產品組合轉變而帶動平均毛利率及毛利總額上升。

本公司仍在擬定本集團截至 2021 年 6 月 30 日止六個月之中期業績。本公告所載列之資料僅基於董事會對本集團截至 2021 年 6 月 30 日止六個月之最新未經審核及尚未經

本公司獨立外聘核數師審閱或審核，亦未經董事會審核委員會審閱之未經審核綜合管理賬目之初步評估。本集團截至 2021 年 6 月 30 日止六個月之未經審核綜合中期業績可能需作進一步調整，並可能與本公告所載資料有所不同。本集團財務資料的進一步詳情預期將於 2021 年 8 月底前公佈之本公司截至 2021 年 6 月 30 日止六個月的中期業績公告中公佈。

**本公司的股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。**

承董事會命  
**晶門半導體有限公司**  
行政總裁  
王華志

香港 · 2021 年 7 月 8 日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事 - 王華志先生 (行政總裁)；(b)非執行董事 - 馬玉川先生 (主席)、王輝先生及葉楠女士；及(c)獨立非執行董事 - 梁享英先生、許維夫先生及陳正豪博士組成。